

INTERNATIONALE

IEC

**INTERNATIONAL
STANDARD**

60749-12

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 12:
Vibrations, fréquences variables**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 12:
Vibration, variable frequency**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –**

Partie 12: Vibrations, fréquences variables

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60749-12 a été établie par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47/1606/FDIS	47/1622/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative aux vibrations à fréquences variables, est le résultat de la réécriture complète de l'essai contenu dans l'article 3 du chapitre 2 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum d'août 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

Part 12: Vibration, variable frequency

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-12 has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/1606/FDIS	47/1622/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to variable frequency vibration, is a complete rewrite of the test contained in clause 3, chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS – MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 12: Vibrations, fréquences variables

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60749 décrit l'essai de vibrations à fréquences variables réalisé pour déterminer l'effet des vibrations sur les éléments de la structure interne, dans les limites de la gamme des fréquences spécifiées. Il s'agit d'un essai destructif. Il est normalement applicable aux boîtiers de type à cavité.

Cet essai de vibrations à fréquences variables est, en général, conforme à la CEI 60068-2-6, mais en raison d'exigences spécifiques aux semiconducteurs, les articles de la présente norme s'appliquent.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-6:1995, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

3 Appareillage d'essai

L'appareillage nécessaire pour cet essai doit comprendre un équipement capable de fournir les vibrations à fréquences variables exigées, aux niveaux spécifiés et l'équipement optique et électrique nécessaire pour les mesures à effectuer à l'issue des essais.

4 Procédure

Le dispositif doit être fixé de manière rigide sur la table de vibrations et les connexions ou les câbles doivent être sécurisés de manière appropriée pour éviter toute résonance excessive dans les connexions. Le dispositif doit être soumis à des vibrations avec un déplacement harmonique simple d'une amplitude soit de 1,5 mm, amplitude double (excursion totale maximale), soit de l'accélération de crête de 200 m/s², en prenant la plus faible de ces valeurs. On doit faire varier la fréquence de vibration entre 20 Hz et 2 000 Hz. L'ensemble de la gamme de fréquences de 20 Hz à 2 000 Hz, en revenant à 20 Hz, ne doit pas être parcouru en moins de 4 min. Ce cycle doit être réalisé 4 fois dans chaque orientation X, Y et Z (au total 12 fois).

4.1 Mesures d'essai

Les essais d'herméticité, dans le cas des dispositifs hermétiques, l'examen visuel et les mesures électriques qui comprennent des essais paramétriques et de fonctionnement doivent être spécifiés dans le document d'approvisionnement applicable.

SEMICONDUCTOR DEVICES – MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 12: Vibration, variable frequency

1 Scope

This part of IEC 60749 describes a test to determine the effect of variable frequency vibration, within the specified frequency range, on internal structural elements. This is a destructive test. It is normally applicable to cavity-type packages.

In general, this variable frequency vibration test is in conformity with IEC 60068-2-6 but, due to specific requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-6:1995, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

3 Test apparatus

Apparatus for this test shall include equipment capable of providing the required variable frequency vibration at the specified levels and the necessary optical and electrical equipment for post-test measurements.

4 Procedure

The device shall be rigidly fastened on the vibration platform and the leads or cables adequately secured to avoid excessive lead resonance. The device shall be vibrated with simple harmonic motion having an amplitude of either 1,5 mm double amplitude (maximum total excursion) or a peak acceleration of 200 m/s^2 , whichever is less. The vibration frequency shall be varied from between 20 Hz and 2 000 Hz. The entire frequency range of 20 Hz to 2 000 Hz and return to 20 Hz shall be traversed in not less than 4 min. This cycle shall be performed four times in each of the orientations X, Y, and Z (total of 12 times).

4.1 Test measurements

Hermeticity tests for hermetic devices, visual examination, and electrical measurements that consist of parametric and functional testing, shall be specified in the applicable procurement document.